

中芯國際介紹

港交所股份代號：**00981**

上交所科創板證券代碼：**688981**

中芯國際投資者關係

2021年5月

前瞻性陳述

本次報告可能載有（除歷史資料外）「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述，包括“季度指引”“資本開支概要”和包含在聯合首席執行官及首席財務官引言裡的敘述，乃根據中芯國際對未來事件或績效的現行假設、期望、信念、計畫、目標及預測而作出。中芯國際使用「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「期望」、「預測」、「目標」、「前進」、「繼續」、「應該」、「或許」、「尋求」、「應該」、「計劃」、「可能」、「願景」、「目標」、「旨在」、「渴望」、「目的」、「預定」、「展望」、和類似的表述，以識別前瞻性陳述，雖然不是所有的前瞻性陳述包含這些詞。該等前瞻性陳述乃反映中芯國際高級管理層根據最佳判斷作出的估計，存在重大已知及未知的風險、不確定性以及其它可能導致中芯國際實際業績、財務狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料有重大差異的因素，包括（但不限於）與半導體行業週期及市況有關風險、半導體行業的激烈競爭、中芯國際對於少數客戶的依賴、中芯國際客戶能否及時接受晶圓產品、能否及時引進新技術、中芯國際量產新產品的能力、半導體代工服務供求情況、行業產能過剩、設備、零件、原材料及軟件短缺、製造產能供給、終端市場的金融情況是否穩定、來自未決訴訟的命令或判決、半導體行業常見的智慧財產權訴訟、宏觀經濟狀況，及貨幣匯率波動。

除本報告所載的數據外，閣下亦應考慮中芯國際不時向香港聯交所及上交所呈報的其他文件。其他未知或未能預測的因素亦可能會對中芯國際的未來業績、表現或成就造成重大不利影響。鑒於該等風險、不確定性、假設及因素，本報告所討論的前瞻性事件可能不會發生。閣下不應過分依賴該等前瞻性陳述，有關前瞻性陳述僅視為於其中所載日期發表，倘並無注明日期，則視為於本報告刊發日期發表。除適用法律可能會有的要求外，中芯國際不承擔任何義務，亦無意圖更新任何前瞻性陳述，以反映該陳述發佈日期之後的事件或情況，或反映該陳述發佈日期之後發生的意外事件，或以反映意外事件的發生，無論是否有新的資訊、將來的事件或是其它原因。

關於非國際財務報告準則（「非國際準則」）的財務計量

合併財務資訊按照國際財務報告準則（“IFRS”）編制，除非另有說明，否則按照國際財務報告準則提交。

中芯國際在此份報告裡使用了非國際準則的營運結果計量，包含調整後的稅息折舊及攤銷前利潤。請協同參閱本集團遵照國際財務報告準則編制的財務計量，具體解釋請參閱業績報告。

本報告內二零二一年一季度業績數據未經審核

I.
中芯簡介

II.
市場機遇

III.
中芯業績

中芯國際是中國內地規模最大，技術最先進的集成電路晶圓代工廠

2000年成立



在港交所及
上交所科創板上市



中國內地
規模最大



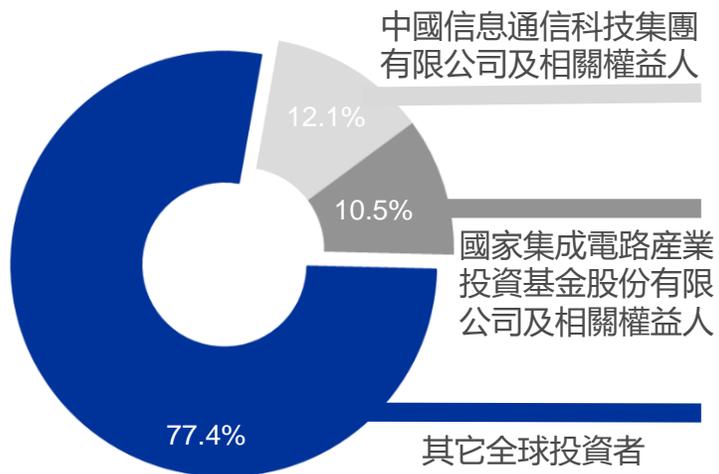
全球晶圓
代工第五



年收入：(單位:十億美元)



股東結構



芯片產業鏈上的中芯國際

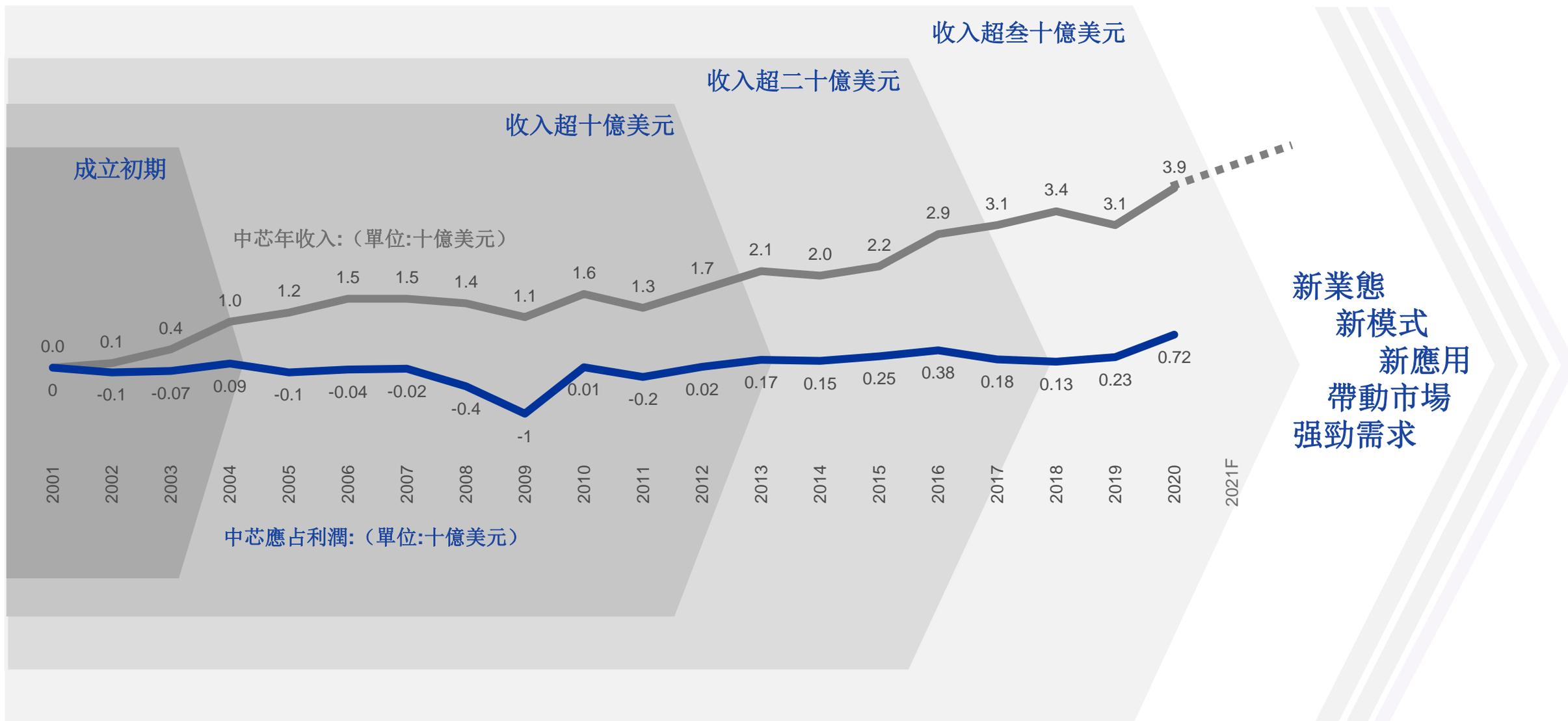


全球分佈



* 來源：SMIC 2020年報

穩健成長，收入規模不斷擴大



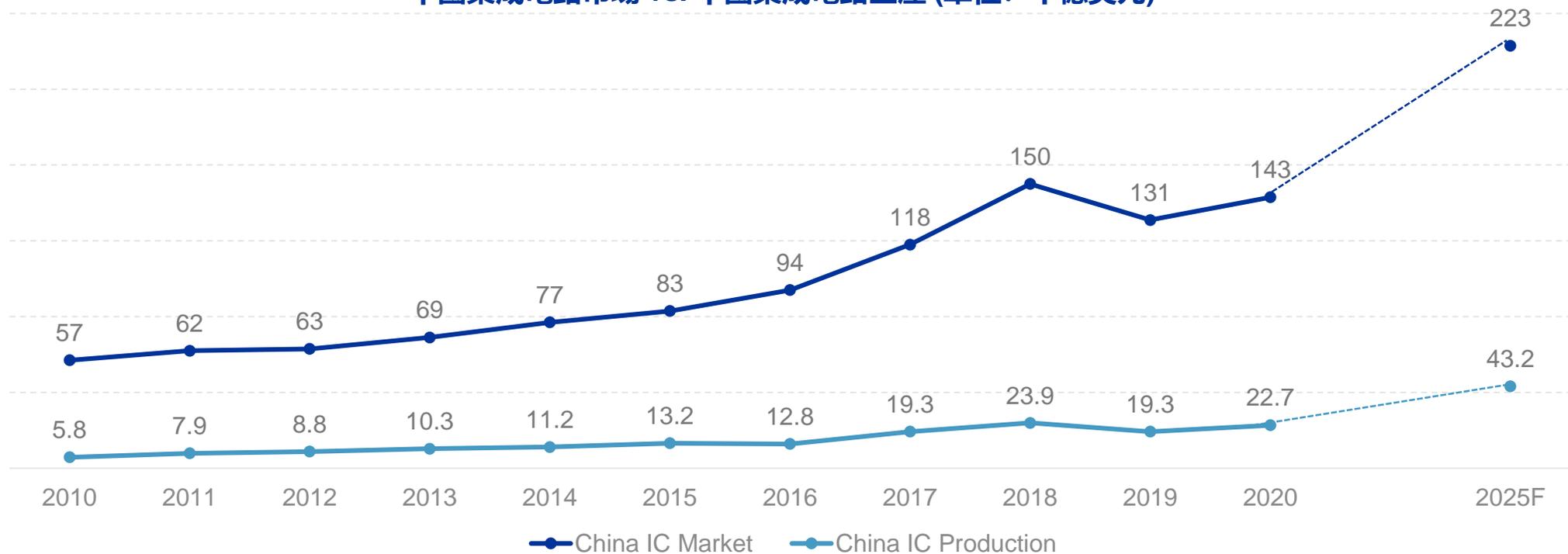
I.
中芯簡介

II.
市場機遇

III.
中芯業績

中國芯片市場快速成長

中國集成電路市場 vs. 中國集成電路生產 (單位: 十億美元)



- 自2005年以來，中國就成為了集成電路消費量最大的國家
- 巨大的自給供應短缺依然存在

I.
中芯簡介

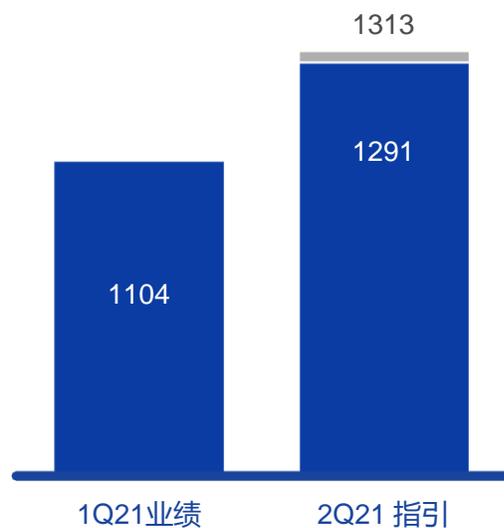
II.
市場機遇

III.
中芯業績

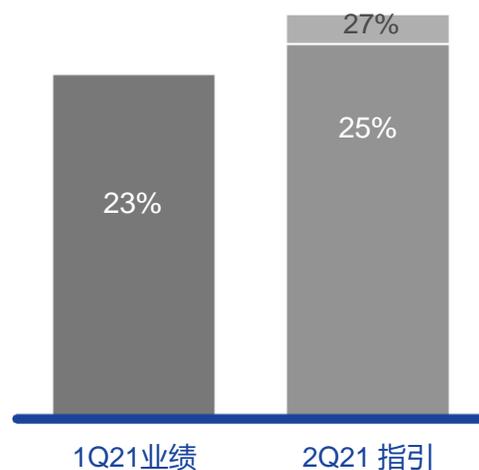
財務摘要及指標



收入(單位:百萬美元)



毛利率

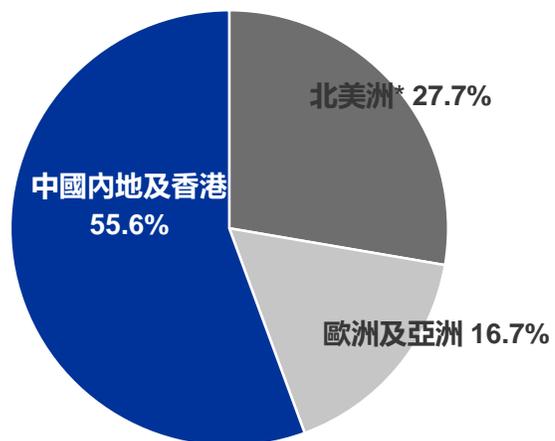


資產負債表 (單位: 十億美元)

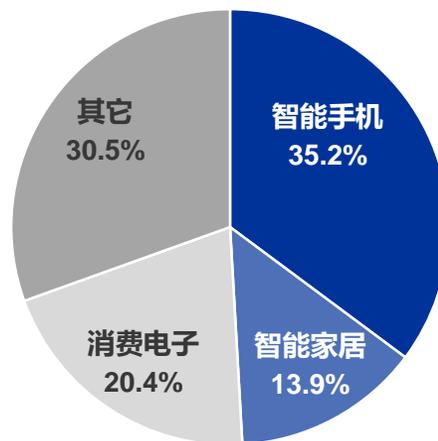


收入來源 – 2021年一季度

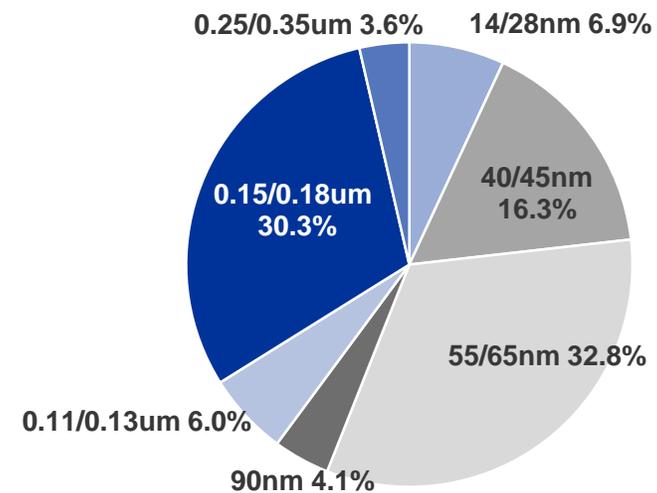
收入按地區分類



晶圓收入按應用分類



晶圓收入按制程分類



*呈列之收入為總公司位於北美，但最終出售及付運產品予全球客戶的公司。

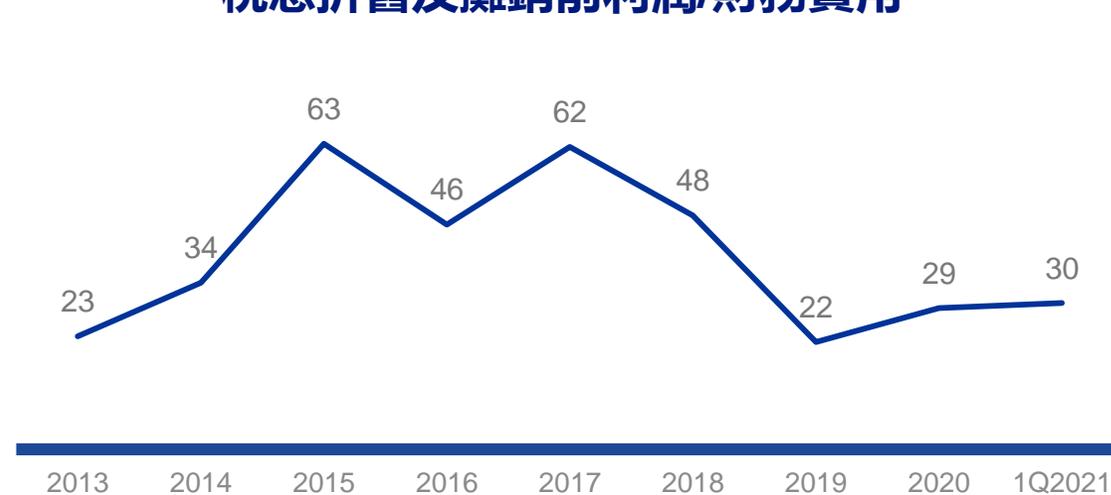
投資級別信用評級

- ✓ 自2013年10月獲得標準普爾投資級別 BBB- 長期公司評級
- ✓ 自2015年10月獲得穆迪 投資級別 Baa3 公司評級
- ✓ 自2015年11月獲得中誠信國際信用評級公司的AAA評級
- ✓ 致力於維持投資信用評級，淨債務對稅息折舊及攤銷前利潤低於2x

淨債務/稅息折舊及攤銷前利潤



稅息折舊及攤銷前利潤/財務費用



• 2020 淨債務定義有更新，具體請參考2020年四季度業績報告

謝謝

聯繫我們: ir@smics.com